

## 展示エリア出展企業・団体

### ■企業・団体（申し込み順）

- リソテックジャパン株式会社 (<https://www.ltj.co.jp/>)  
「未定」
- 株式会社 SCREEN セミコンダクターソリューションズ (<https://www.screen.co.jp/spe/>) 2ブース  
「SCREEN の半導体製造装置およびソリューション」
- ローム株式会社 (<https://www.rohm.co.jp/>)  
「MEMS ガスセンシング技術、MEMS 加工技術」
- 株式会社村田製作所 (<https://www.murata.com/ja-jp>)  
「エッジ AI モジュール」
- ニッタ・デュポン株式会社 (<https://www.nittadupont.co.jp>)  
「半導体製造 平坦化 CMP 材料」
- ハイデルベルグ・インストルメント株式会社 (<https://www.himt-jp.com/>)  
「直接描画装置マスクレスアライナーのご紹介」
- セイノーホールディングス株式会社 (<https://www.seino.co.jp/seino/shd/>)  
「On behalf of OOO ~Plus New Value~ (電子デバイス産業向け物流ソリューション)」
- 田中貴金属工業株式会社 (<https://gold.tanaka.co.jp/>)  
「高密度実装向け Au 粒子接合技術」
- 株式会社 堀場製作所 (<https://www.horiba.com/jpn/>) 2ブース  
「電子デバイス産業において信頼される、分析・計測・流体制御機器」
- 北海道苫小牧市 (<https://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/>)  
「次世代半導体関連産業誘致」
- エヌディアイ株式会社 (<http://www.ndikk.co.jp>)  
「海外製品技術紹介 Premtek 社製、TCW 製品、Benchmark Technology 社製品」

### ■「車載電子デバイスパビリオン」 中会議室 A

- 株式会社村田製作所 (<https://www.murata.com/ja-jp>)

### ■「マテリアル先端リサーチインフラ事業」 2ブース

- 京都大学 (<http://www.kyoto-u.ac.jp/ja>)
- 大阪大学 (<https://www.osaka-u.ac.jp/ja>)
- 奈良先端科学技術大学院大学 (<http://www.naist.jp/>)
- 山形大学 (<https://yamagata-u.ac.jp>)

### ■ポスター展示

- 野村マイクロ・サイエンス株式会社 (<https://www.nomura-nms.co.jp/>)
- NEDIA 戦略マップ委員会